

Pelnox®

产品名称	ME-276/HV-138
产品分类	单个半导体封装树脂 车载电装品 各种传感器用
主要用途	半导体模组 车载电装品
主要功能	耐热性 难燃性 固化收缩小 低翘曲 耐冷热冲击 耐湿性

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-276	HV-138
外观	目测	—	黑色液体	灰白色液体
比重	25℃	—	1.91	1.85
粘度	25℃	mPa·s	50,000	15,000
配比	重量比		100/100	
操作时间	25℃ 粘度2倍值	小时	4	
胶凝时间	100℃ 40g	分	20	
初期混合粘度	25℃	mPa·s	38,000	

标准固化条件 100℃-1小时+140℃-1小时+180℃-1小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
固化物比重	浮力法 25℃		1.88
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	93
玻璃化温度	TMA法	℃	186
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	1.5
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	6.2
弯曲强度	JIS K-6911	MPa	100
弯曲模量	JIS K-6911	MPa	10,000
剪切粘接力	JIS K-6850 Al-Al	MPa	9
	JIS K-6850 Cu-Cu	MPa	10
固化收缩率		%	0.04
导热系数	快速导热测定仪	W/mk	0.60
比热	JIS K-7123 25℃	J/g·deg	0.620
	100℃		0.730
	200℃		0.860
绝缘破坏电压	JIS K-2110 25℃	kV/mm	19
	150℃		20
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	6.8 x 10 ¹⁵
	JIS K 6911 煮沸2小时	Ω-cm	2.4 x 10 ¹⁵
吸水率	JIS K 6911 煮沸2小时	wt%	0.1
难燃性	UL-94		V-0相当

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店 〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心 〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022